



新聞聯絡人：

MCA Public Relations
Stephen Brennan
Phone: +1-650-968-8900 ext. 114
Email: sbrennan@mcapr.com

廿一世紀公關顧問
葉惠宜、劉怡
電話：(02) 2577-2100 分機 819、803
傳真：(02) 2577-1600
E-mail：aprilhi.yeh@erapr.com
kay.liu@erapr.com

**十九家電子產業領導廠商通力合作
加速擴展 SOI 創新之市場**

SOI 產業聯盟致力降低成本並擴展新市場

台北訊—10 月 11 日—電子產業多家頂尖廠商聯合宣佈成立 SOI 產業聯盟，期許透過推廣 SOI 技術的優點，並且降低採用 SOI 的障礙，以加快擴展絕緣層上覆矽 (Silicon-on-Insulator, SOI) 技術創新的市場。

效能與功耗可說是現今整體電子產業的主要考量因素。早期採納的業者憑藉著自己的力量，成功地證明 SOI 是一種可滿足上述考量的卓越解決方案。然而，當新一波廠商評估是否加入時，則需要成熟、完整，並可立即取得的 SOI 設計平台及 IP 方案，以確保他們能擁有透明化的設計平台與低成本的製造方案。SOI 聯盟成立的目標便是透過降低採用成本的方式，弭平這些實際的或是想像的鴻溝，使 SOI 成為整個價值鏈中的最佳典範，並且提供設計範例。

SOI 產業聯盟的創始成員橫跨使用者、支援業者、供應商及製造商，包括超微 (AMD)、安謀 (ARM)、益華電腦 (Cadence Design Systems)、法國電子和資訊技術實驗室 (CEA-Léti)、特許半導體 (Chartered Semiconductor Manufacturing)、飛思卡爾 (Freescale Semiconductor)、國際商業機器 (IBM)、Innovative Silicon、科磊 (KLA-Tencor)、科林研發 (Lam Research)、恩智浦 (NXP)、三星 (Samsung)、Semico、Soitec、SHE Europe、義法半導體 (STMicroelectronics)、新思科技 (Synopsys)、台積電 (TSMC)，以及聯電 (UMC)。(以上按英文字母順序排列)

新當選的 SOI 產業聯盟主席 André-Jacques Auberton-Hervé 表示：「趁著產業對效能的需求潮流，SOI 技術在市場上已擁有相當可觀的進展。而現在，產業注目的焦點更進一步擴展至降低功耗。SOI 技術一項極為重要的優勢，便是能夠大幅降低耗電量，無論是維持營運資料中心的正常運作，或是手機有足夠電力看完整場球

賽。結合使用者及支援廠商，SOI 產業聯盟致力於找出並消弭設計鏈中的鴻溝，讓 SOI 技術成為各個市場中設計業者的最佳選擇之一。」

SOI 產業聯盟將致力於達成以下三個主要目標：

- 確保使用者的需要被準確地接收、瞭解及因應；
- 加快並促成產業體系間的合作，支援邁入矽元件階段的解決方案；
- 向更多電子產業業者推廣 SOI 的各項利益、技術創新，以及發展潛力。

市場分析機構 Gartner 半導體研究部門副總裁 Bryan Lewis 表示：「SOI 帶來的利益已獲得業界多數重要廠商的認可。同時，其技術發展距離主流市場僅剩臨門一腳。半島體產業鏈中的各個公司，都正加碼投資時間及金錢在 SOI 技術的進一步發展上，而這些投資將會加速 SOI 技術針對各種裝置及應用的改良，包括耗電量的降低及效能的提升。」

聯盟的初期工作焦點，是分享早期採用客戶發展出的最佳策略、推動新的成功設計方案、展示 SOI 在效能、功耗及密度等方面的優勢。聯盟的董事會成員將於十月份投票選出。

關於 SOI 產業聯盟

SOI 產業聯盟成立的宗旨在加速絕緣層上覆矽 (SOI) 技術之創新發展、將版圖擴展至更多市場、推廣 SOI 技術的各項利益，以及排除業者採用的障礙。SOI 產業聯盟的創始成員包括整個電子產業架構中的領導業者，包括：超微 (AMD)、安謀 (ARM)、Cadence Design Systems、法國電子和資訊技術實驗室 (CEA-Léti)、特許半導體 (Chartered Semiconductor Manufacturing)、飛思卡爾 (Freescale Semiconductor)、國際商業機器 (IBM)、Innovative Silicon、科磊 (KLA-Tencor)、科林研發 (Lam Research)、恩智浦 (NXP)、三星 (Samsung)、Semico、Soitec、SHE Europe、義法半導體 (STMicroelectronics)、新思科技 (Synopsys)、台積電 (TSMC)，以及聯電 (UMC)。該聯盟開放電子產業所有企業與機構一同參與。如欲獲得詳細資訊，請瀏覽下列網站：[www.\[tbd\]soiconsortium.org](http://www.[tbd]soiconsortium.org)。

免責聲明

SOI 產業聯盟，包括由 SOI 產業聯盟行政人員口頭發表、透過書面簡報，或者其他任何溝通管道發表之各項觀點及意見，並不一定代表產業聯盟中個別企業及組織的觀點及意見。SOI 產業聯盟行政人員代表聯盟的發言，僅代表產業聯盟本身的觀點，而不應被視為聯盟中個別企業及組織，或者聯盟的合作夥伴的發言。針對觀點及意見的更改，SOI 產業聯盟無通知義務，同時也不負有更新此類資訊的義務。



SOI 產業聯盟創始會員宣言

超微 (AMD)

AMD Fab 36 副總裁 Udo Nothelfer 表示：「SOI 為 AMD 提供了一個理想平台，讓我們能在此架構上開發各種高效能、低功耗的微處理器。運用 SOI 達成效能與降低功耗的獨特組合，讓 AMD 能持續扮演 x86 產品創新領導者的角色。」

安謀 (ARM)

ARM 實體 IP 部門行銷副總裁 Tom Lantzsch 表示：「身為處理器與實體 IP 領導廠商，ARM 一向致力於提供業界最省電的產品。我們相信 SOI 技術的興起，將帶動業界提供各式低功耗應用。ARM 加入 SOI 產業聯盟，將使我們的客戶加快採納 SOI 的腳步。」

益華電腦 (Cadence Design Systems)

Cadence 行銷與策略全球副總裁 Craig Johnson 表示：「對於 SOI 產業而言，設計技術是一項重要的發展關鍵。而我們的產品已被應用在許多成功的 SOI 設計中。身為 EDA 的領導者，以及 SOI 聯盟的成員，Cadence 期盼能協助客戶開發新一代 SOI 設計，並加快 SOI 產業的創新腳步。」

法國電子和資訊技術實驗室 (CEA-Léti)

CEA-Léti 執行長 Laurent Malier 表示：「CEA-Léti 為 Smart Cut™ 技術及許多 SOI 設計創新科技的發源地，同時也是在先進 SOI 基板上開發 CMOS 與射頻技術的領導者。因此，我們理所當然地加入了 SOI 聯盟，並與其他同樣也是會員一流廠商並駕齊驅。透過完整的 SOI 價值鏈提供其專業技術，藉以擴展此一尖端技術的發展版圖。」

特許 (Chartered)

Chartered 產業行銷及平台聯盟副總裁 Kevin Meyer 表示：「終端市場需求驅動整體產業的發展，並進一步要求更多可滿足功耗管理、效能及成本需求的創新方法。SOI 不僅扮演催化劑的角色，增進各種運算與遊戲應用的功耗 / 效能比，更帶動 Chartered 在晶圓代工事業的成長。作為此聯盟的創始會員，Chartered 努力將

SOI 的價值延伸到其他需要類似創新的市場，以解決各種複雜的挑戰，並滿足終端市場的需求。」

飛思卡爾 (Freescale)

Freescale 技術長暨資深副總裁 Lisa Su 表示：「綜觀 Freescale 處理器的發展，Freescale 多年來一直是 SOI 技術的領先採用業者。SOI 技術在降低耗電量的同時，還能增進系統層級的關鍵效能。SOI 聯盟的創立將協助此技術進一步擴展寬頻應用版圖，讓更多終端使用者享受此項技術的價值。」

國際商業機器 (IBM)

IBM 半導體平台副總裁 Mark Ireland 表示：「IBM 一向致力分享我們的技術，以刺激業界之間的合作，並與業界領導業者建立開放性社群。而我們的系統之所以能持續保有業界領先的地位，SOI 技術功不可沒。同時，我們更相信 SOI 在許多應用上，將能改變整體市場的勢態。為了因應客戶對 SOI 的需求，IBM 為市場帶來嶄新的 OEM 產品—第一個 45 奈米 ASIC，以及最近推出的 130 奈米射頻元件。我們期盼與 SOI 聯盟密切合作，以進一步推廣 SOI 技術的採用，發揮其優異的效能與節能效率。」

Innovative Silicon

Innovative Silicon 行銷副總裁 Jeff Lewis 表示：「我們非常榮幸能夠成為 SOI 產業聯盟的創始會員之一。包括我們的 Z-RAM 記憶體 IP 在內的各種 SOI 元件，都是為了在功耗、效能、密度及成本各方面，提供超越量產型 CMOS 的優勢。此聯盟結合了業界各個層面的領導廠商，將帶動產業在近期全面採用 SOI 設計與技術。」

科磊 (KLA-Tencor)

KLA-Tencor 行銷長 Brian Trafas 表示：「SOI 的快速成長，為各種半導體設計帶來重要的效能與效率優勢。在未來幾個晶片世代中，我們相信該聯盟將協助我們了解並解決 SOI 技術將面臨在檢驗與量測上的挑戰，並協助已採用或準備採用 SOI 元件的晶片製造商大幅提升良率。」

Lam Research Corp

Lam Research 全球副總裁暨總經理 Richard Gottscho 表示：「SOI 技術在協助我們客戶提供更高效能的產品上占有極為關鍵的地位。藉由加入此聯盟，Lam 不僅可以瞭解 SOI 晶圓在加工與整合過程中將會出現的問題，Lam 更進一步持續實踐對客戶的承諾，在任何挑戰出現在晶圓製造過程之前，即提出對應的解決方案。加入 SOI 聯盟不僅使 Lam 成為 SOI 技術的先驅，也使我們和這項領先技術的成功關鍵站在同一陣線。」

恩智浦 (NXP)

NXP 採購長暨副總裁 Derek Wallace 表示：「身為 SOI 技術的開發業者，以及長期採用的廠商，我們非常高興能進一步開發 SOI 項技術，並擴展新的應用版圖。此聯盟為推廣與規劃這些新的發展，提供了一個合作的平台。」

Semico

Semico Research 總裁 Jim Feldhan 表示：「Semico 很榮幸成為 SOI 產業聯盟的創始會員。同時，我們也很高興能夠及早發現這個剛起步的創新技術。早在三年前，Semico 便已發現 SOI 在帶動半導體產業效能與低功耗應用上持續發展的潛力。而如今，SOI 已推廣至許多高產量的應用層面。SOI 未來的發展前景相當看好，許多以往採用量產型 CMOS 技術的應用，都紛紛著手評估 SOI 技術，以符合未來新世代設計的需求。」

Soitec

Soitec 執行長暨董事長 André-Jacques Auberton-Hervé 表示：「作為 SOI 的先鋒業者，我們非常高興看到 SOI 產業聯盟的創立。這個聯盟背後的動力，來自最終使用者的各項需求，包括從電路設計與基板開發，一直到製造、封裝及系統整合等整個價值鏈。在每個步驟中，我們都發現 SOI 能增進效能與功能，並降低功耗與成本。各家廠商齊心協力分享最佳策略，並聯繫更多電子產業的業者。因此，我們能把這些優點推廣到各個新市場，讓所有人獲益。」

義法半導體 (STMicroelectronics)

STMicroelectronics 高效能邏輯及衍生物先進研發事業群前端技術及製造部門副總裁 Mike Thompson 表示：「身為 SOI 技術的長期開發業者，STMicroelectronics 全力支持能夠協助業者分享經驗、探索 SOI 的各項利益的 SOI 聯盟。」

新思科技 (Synopsys)

Synopsys 策略市場發展副總裁 Rich Goldman 表示：「SOI 在克服效能與功耗上扮演者相當重要的角色。作為 SOI 聯盟的創始會員，Synopsys 希望貢獻我們在電子設計與 IP 方面的能力，把 SOI 推向主流。」

台積電 (TSMC)

TSMC 設計暨技術平台副總經理許夫傑表示：「身為專業積體電路製造服務領導廠商，台積電提供多樣完備且具有成本競爭優勢的標準矽晶圓製造技術平台(Bulk silicon-based technology platform)，為我們的客戶生產眾多不同應用的產品。在高效能與低功耗產品製造方面，SOI 是新興的利基型技術之一，採用時需權衡各種不同考量，值得業界繼續評估。作為此聯盟的創始會員，台積電將提供在技術平台整合以及量產方面的豐富經驗，支援現有或具有潛力的 SOI 產品的發展。」

聯電 (UMC)

UMC 市場行銷處副總鍾立朝表示：「我們很榮幸能成為 SOI 產業聯盟的創始會員。加入這項計畫，將進一步促進業界採納 SOI 這項極具吸引力的技術方案，以協助新世代的 SOC 增進效能並降低功耗。在 UMC 開始為晶片設計業者提供絕緣層上覆矽技術之際，我們也期盼 SOI 能更加普及化。」